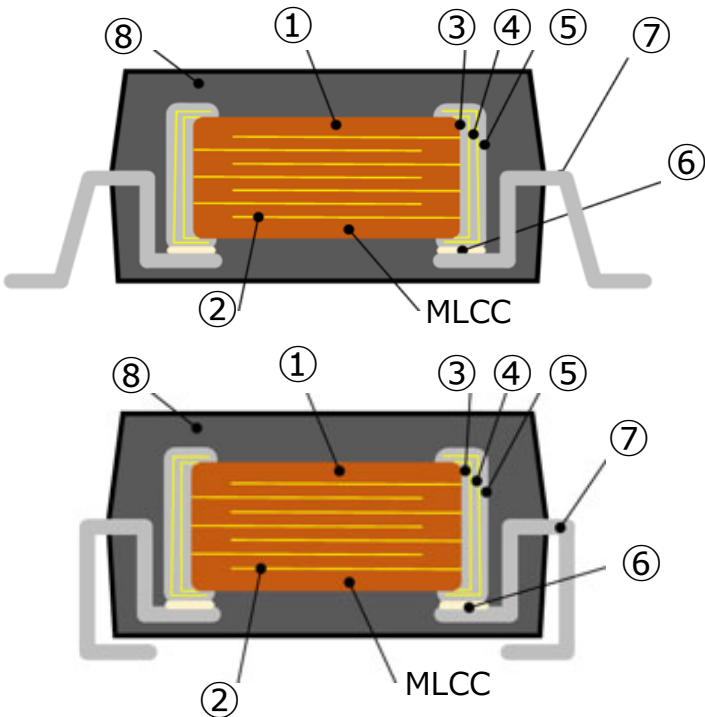


構造図
STRUCTURE and MATERIAL

樹脂モールド面実装タイプ積層セラミックコンデンサ
Resin Molding SMD Type Multilayer Ceramic Capacitors



構成表 CONSTRUCTION

構成材 Item			NO.	材料名 Material description
チップ積層セラミック コンデンサ Chip Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC)	誘電体 Dielectric		①	セラミック Ceramic
	内部電極 Inner electrode		②	Ni
	外部電極 Outer Electrode	第 1 層 base layer	③	Cu
		第 2 層 2nd layer	④	Ni
		最外層 Outer layer	⑤	Sn
金属端子接合材 Joint material of metal terminal and outer electrode of chip capacitor			⑥	Sn-Sb系はんだ Sn-Sb solder
金属端子 Metal Terminal			⑦	鉄系合金（Ni/Snめっき） Ferric alloy（Ni/Sn plating）
外装 Enclosure			⑧	エポキシ系樹脂（UL94V-0 認定品） Epoxy resin（Conforming to UL94V-0 standard）